



Tagesordnung

Thema: 76. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“

Datum: **19. Oktober 2022, 10.00 Uhr**

Ort: Online via MS Teams

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
**Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Abfrage Themen/Schwerpunkte für 2023**
Herr Herr Walter, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
**In-situ infrared spectroscopy for chemical analysis in electronic
packaging processes**
Frau Corinna Niegisch, Robert Bosch GmbH, Stuttgart
- 3 10:50 Uhr
**Vertrauenswürdige Elektronik - Schutz von Baugruppen und LTCC-
Modulen vor Fälschung und Manipulation**
*Herr Dr.-Ing. U. Krieger, VIA electronic GmbH, Hermsdorf /
Herr Dr.-Ing. P. Uhlig, IMST GmbH, Kamp-Lintfort*
- 4 11:25 Uhr
**Elektrische Sicherheit von Lötmaterial in der Verbindungstechnik.
Ein Einblick in die Praxis**
Frau Diana Merkwitz, Stannol GmbH & Co KG, Velbert

Mittagspause

- 5 13:00 Uhr
Aluminium Dünndraht Bonden auf verschiedenen Dickschicht Gold und Keramiken
Herr André Kießig, Kolektor SIEGERT GmbH, Caodolzburg
- 6 13:40 Uhr
Scherwedge zur Beurteilung der Verbindungsqualität
Herr Simon Kuttler, TU-Berlin
- 7 14:10 Uhr
Neue Möglichkeiten der Zuverlässigkeitsprüfung mittels beheizter Leiterplatten
Herr Dirk Seehase, Uni Rostock
- 8 14:50 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Hans Walter, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 15:00 Uhr